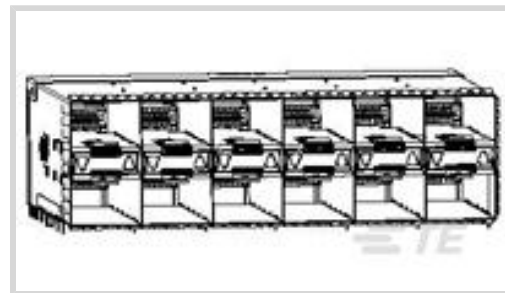




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > zSFP+ 堆叠壳体组件：EMI 弹片



插拔式 I/O 产品类型: **带集成连接器的壳体组件**

中心线 (间距) : .8 mm [.032 in]

可密封: 否

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 zSFP+ 堆叠壳体组件：EMI 弹片 \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
可密封	否
外形尺寸	zSFP + 堆叠 (SFP28)

结构特性

光管种类	标准
位数	240
端口数量	12
端口矩阵配置	2 x 6

电气特征

数据速率 (最大值)	32 Gb/s
------------	---------

接触件特性

尾部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.8 mm[.07 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

壳体特性

笼子材料	镍/银合金
中心线 (间距)	.8 mm[.032 in]

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.5 mm[.059 in]
-------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	zSFP+ 热增强型
兼容的散热器	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2198339-8_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2198339-8_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2198339-8_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[zSFP+ Interconnect Brochure](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本